



[kingston.com/epop](http://kingston.com/epop)

## ePoP

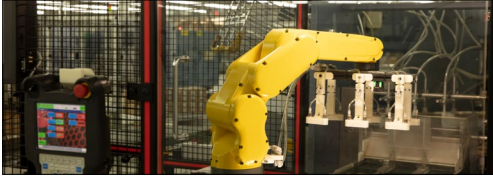
### 面向可穿戴设备的嵌入式堆叠封装内存

Kingston 的 ePoP 提供高度集成的 JEDEC 标准组件，将 Embedded MultiMedia Card (eMMC) 存储和 Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM 整合进堆叠封装 (PoP) 的解决方案。ePoP 将直接安装到主机片上系统 (SoC) 的上部，这可以缩小印刷电路板 (PCB) 尺寸并确保最优性能。ePoP 非常适合可穿戴设备等空间有限的应用。

## 主要优势

- 通过直接安装到主机 SoC 的上部，ePoP 为可穿戴设备等小尺寸应用提供了理想解决方案。
- 低功耗 DRAM 和优化的存储固件可降低功耗，同时提供电池供电的可穿戴设备应用所需的高性能。
- 简化系统设计、加速产品上市并缩短认证周期。
- 多种固件配置可用，完美匹配应用对性能、功耗和说明的要求。

## 市场细分



物联网 (IoT)



可穿戴设备



增强现实 (AR) / 虚拟现实 (VR) 设备

## EPOP 产品型号和规格

### 基于 LPDDR4x 的 ePoP

产品型号	容量		描述		封装尺寸	FBGA	工作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.65	144	-25°C ~ +85°C

### 基于 LPDDR5x 的 ePoP

产品型号	容量		描述		封装尺寸	FBGA	工作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.7	201	-25°C ~ +85°C

